证券代码:688216　证券简称:气派科技　公告编号:2026-040

气派科技股份有限公司关于对上海证券交易所《关于气派科技股份有限公司 2025 年年度报告的信息披露监管问询函》的回复公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

气派科技股份有限公司(以下简称“公司”或“气派科技”)于 2026 年 6 月 15 日收到上海证券交易所下发的《关于气派科技股份有限公司 2025 年年度报告的信息披露监管问询函》(上证科创公函【2026】0338 号)(以下简称《问询函》),根据《问询函》的要求,公司与天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“会计师”),对问询函所列问题进行了认真核查并作出如下回复。

说明:本回复报告中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况,均为四舍五入所致。

一、关于业绩下滑

年报显示,2022 年至 2025 年公司连续亏损,各年归母净利润分别为 -5,856.03 万元、-13,096.69 万元、-10,211.37 万元、-7,538.40 万元。单季度看,2025 年第四季度公司净利润 128.48 万元,系 2022 年第三季度以来首次实现单季度盈利;2026 年第一季度,公司再次转亏。截至 2025 年末,公司未弥补亏损 5,605.90 万元,净资产 61,641.55 万元。

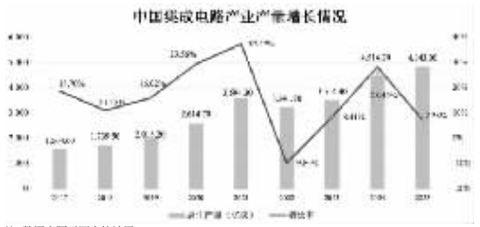
请公司:(1)结合行业周期、下游需求、技术迭代、市场竞争、产品及客户结构等,详细分析公司持续亏损的原因,说明公司持续经营能力是否存在重大不确定性;(2)分析 2025 年第四季度公司盈利的原因,说明是否依赖于偶发性、非经常性因素,并分析扣除上述因素后的盈利情况,盈利能力是否发生实质性改善;(3)说明公司已采取和拟采取的改善经营业绩的具体措施(如产品结构优化、客户拓展、成本控制、资产处置等),并量化分析相关措施预计产生效益的时间、金额及可实现性;(4)列示 2025 年第四季度前五大客户、合作历史、2025 年各季度销售金额、第四季度末应收账款余额、期后回款及退换货情况等;(5)结合 2025 年第四季度及 2026 年第一季度发货及验收时点、收入确认依据、成本费用归集期间、期后回款及退换货情况,核实并说明 2025 年第四季度是否存在突击确认收入、推迟确认成本费用以及跨期调节利润等情形,请年审会计师详细说明针对收入成本费用所执行的截止性测试、细节测试情况。

回复:

(一)结合行业周期、下游需求、技术迭代、市场竞争、产品及客户结构等,详细分析公司持续亏损的原因,说明公司持续经营能力是否存在重大不确定性

1、行业周期及下游需求

2022 年至 2025 年,公司所处半导体封装测试行业整体呈现周期性波动特征,行业周期变化与下游需求变化具有较强联动关系。2022 年以来,受全球宏观经济波动及终端消费电子需求下行影响,行业进入调整阶段,下游需求收缩带动产业链进入去库存周期,行业整体盈利水平承压。



注:数据来源于国家统计局。

从行业数据来看,中国集成电路产业产量由 2021 年的 3,594.30 亿块变动至 2022 年的 3,241.90 亿块,同比下降约 9.80%;2023 年产量约 3,514.40 亿块,同比增长约 8.41%;2024 年产量约 4,514.20 亿块,同比增长约 28.45%;2025 年产量约 4,843.00 亿块,同比增长约 7.28%,整体呈现先调整后恢复的周期性变化特征。

在行业周期波动背景下,下游需求与行业景气度保持一致变化趋势。2022 年以来,下游消费电子需求走弱带动客户需求整体收缩,订单释放节奏放缓;2023 年以来,行业逐步进入修复阶段,下游需求有所恢复但仍处于调整与修复并存阶段;2024 年至 2025 年,随着库存去化逐步完成,下游整体需求水平逐步回升,但恢复过程仍存在阶段性波动。受行业周期及下游需求恢复影响,公司收入端改善受到行业传导节奏影响,恢复进程呈现一定滞后性。

2、技术迭代

半导体封装测试行业属于技术密集型行业。随着终端应用向小型化、智能化、高性能及高可靠性方向发展,封装测试技术持续演进,QFN/DFN、LQFP、LGA、FC、CSP、WLCSP、MCM、SiP 等中高端及先进封装形式的应用范围逐步扩大,行业整体呈现传统封装与中高端、先进封装并行发展的趋势。

公司主要产品包括 SOT、SOP、DFN/QFN 系列产品,2023 年度至 2025 年度上述产品合计销售收入占主营业务收入的比例分别为 87.38%、88.60%和 88.93%,已形成覆盖传统封装及中高端封装的产品体系。截至 2025 年 12 月 31 日,公司累计拥有境内外专利 316 项,其中发明专利 56 项,具备较强的技术积累和知识产权基础。

公司常规封装测试产品主要包括 SOP、SOT 等系列产品,主要应用于消费电子、智能家居、工业控制等终端领域,具有性价比高、产品通用性强、使用成本低、应用领域广等特点。该类产品的封装技术、封装工艺及可靠性要求已较为成熟,市场需求呈现稳定增长趋势,行业技术迭代主要体现为不同应用场景下集成度、散热性能及可靠性要求的持续提升,并不必然带来封装形式的替代,即 SOP、SOT 等常规封装形式在未来的较长时间内也不会被先进封装形式替代。因此,公司常规封装测试产品短期内不存在因技术快速迭代导致产品竞争力下降的重大风险。

公司主要中高端封装测试产品为 QFN/DFN 系列产品。近年来,QFN/DFN、LQFP、LGA、FC、CSP、WLCSP、MCM、SiP 等中高端封装测试产品的应用范围逐步扩大,相关技术路线已趋于成熟或已形成较为明确的发展方向。该等产品的技术演进主要体现为工艺优化、产品性能提升及应用领域拓展,并非基础技术路线的重大变化。因此,中高端封装测试产品短期内不存在明显的技术迭代风险,公司现有 QFN/DFN 系列产品亦不存在因技术路线重大变化而被快速替代的情形。

总体来看,半导体封装测试行业技术迭代具有渐进式、分层次特征,传统封装与中高端、先进封装在应用领域、成本结构、性能要求及客户需求方面存在差异,未来较长时期内各封装形式产品仍将并存发展。公司现有主要产品所处细分领域技术路线相对成熟,同时公司已在 QFN/DFN 等中高端封装产品方面形成量产能力、客户基础和技术积累,具备跟进行业技术演进的基础,短期内不存在因行业技术迭代导致主要产品被快速替代或持续经营能力受到重大不利影响的情形。

3、市场竞争

相对于芯片设计和晶圆制造产业来说,中国封装测试领域的技术水平和销售规模与国际知名企业的水平持平,以长电科技、通富微电和华天科技为典型代表,作为国内封装测试行业的龙头企业,已居全球封装测试企业前十强。

全球半导体产业经历二次产业转移,目前处于第三次产业转移的进程之中,作为半导体领域壁垒相对较低的领域,封测产业目前主要转移至亚洲区域,主要包括中国大陆、中国台湾、东南亚等。

我国半导体封测行业属于市场化程度较高的行业,衡量行业竞争力的关键指标通常包括技术创新能力、生产效率、产品质量、市场占有率、客户服务能力和供应链整合能力等。

从国内竞争结构来看,行业已形成较为清晰的分层体系,具体如下:

国内半导体封装测试企业类别

类型	主要特征		主要优势	代表厂商
行业内规模或技术具有领先优势的企业	规模大、综合实力强、引领行业技术和产品创新,高效、严格的品质管理体系;外资企业以 BGA、CSP、WLCSP、PC、MEMS、Bumping、TSV 等为主,内资企业在先进封装产品市场已占有一定比例		技术、市场和资金优势	长电科技、华天科技、通富微电及安靠科技、日月光等在国内设立的封装测试企业
具备一定规模、具备较强技术实力的中等规模企业	规模中等,具备较强的技术实力和完整的品质管控体系,专注于技术应用和工艺创新,以 SOT、SOP、OFP、QFN/DFN、LQFP 等系列产品为主,逐步向 CSP、FC、TSV、SIP 等先进产品延伸		拥有较强的研发和技术能力,具有完善的生产与质量管理体系;产品性价比高、竞争力强	以气派科技、华宇电子等为代表的中等规模企业
规模较小的企业	规模较小、技术或生产管理能力一般,主要以 TO、DIP、SOP 等产品为主		无明显优势	数量众多的中小型企业

从上可知,目前国内综合性封装测试市场形成了较为明显的三个层次,长电科技、华天科技、通富微电等全球性知名企业,其市场开拓重心逐步转移至 SIP、TSV、WLCSP 等先进封装领域,气派科技、华宇电子等具备一定规模、较强技术实力的中等规模企业,目前以常规和中高端封装产品为主,逐步向先进封装领域延伸;除此以外,还存在数量较多的规模较小、技术能力一般的中小型企业,该等企业以常规封装产品为主。

从具体封装形式产品来看,长电科技、通富微电、华天科技等头部企业重心向先进封装形式产品转移,其在先进封装产品领域市场竞争能力强,SOP、SOT 等常规封装形式产品甚至 QFN/DFN 等中高端封装形式产品投入力度不大(甚至已不再投入);气派科技、华宇电子等中等规模企业因具备较大规模、具备较强技术实力,SOP、SOT、QFN/DFN 等产品具备与长电科技、通富微电、华天科技等头部企业同等的技术实力,在成本管控等方面具备一定竞争优势。

从封装测试市场来看,常规封装产品市场竞争较为激烈,在行业景气度下行时竞争程度会进一步加剧;相较常规封装产品,先进封装测试产品市场竞争相对较好。

4、产品及客户结构

2023 年度至 2025 年度,公司主营业务收入构成情况如下:

单位:万元

产品名称	2025年度		2024年度		2023年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
SOT	24,357.07	33.08%	18,633.74	29.72%	17,750.45	34.05%
SOP	15,941.50	21.65%	16,813.43	26.82%	14,099.48	27.04%
DFN/QFN	25,181.57	34.20%	20,099.06	32.06%	13,703.89	26.29%
CPC	2,163.56	2.94%	2,073.02	3.31%	2,057.07	3.95%
LQFP	529.65	0.72%	577.92	0.92%	937.92	1.80%
其他	4,716.29	6.41%	4,193.50	6.69%	3,484.45	6.68%
晶圆测试	744.79	1.01%	309.45	0.49%	100.57	0.19%
合计	73,634.44	100.00%	62,700.12	100.00%	52,133.82	100.00%

从产品结构来看,公司收入主要来源于 SOT、SOP 及 DFN/QFN 等封装产品,其中中高端封装产品 DFN/QFN 产品收入占比逐年提升,2023 年度至 2025 年度分别为 26.29%、32.06%及 34.20%。

公司产品结构布局多元,除传统 SOT、SOP 系列外,在 DFN/QFN 封装体系中已形成多规格、多尺寸产品组合,能够覆盖不同功率及应用场景需求,体现出公司在封装工艺兼容性及产线柔性化配置方面的能力。

公司客户主要为芯片设计企业,半导体封装测试行业下游客户由于终端应用场景较多、芯片品类及封装规格差异较大,封测企业通常服务于较多客户,客户结构相对分散。较为分散的客户结构有助于降低单一客户需求波动对公司经营业绩的影响,增强公司订单获取及收入来源的稳定性。2023 年度至 2025 年度,公司前五名客户情况如下:

单位:万元

2025年度				
序号	客户名称	主要产品应用领域	销售金额	占比
1	南京微盟电子有限公司	消费电子、工业控制、汽车电子、智能家居等	8,309.80	10.81%
2	普冉半导体(上海)股份有限公司	消费电子、智能家居、工业控制、物联网等	5,001.09	6.51%
3	深圳英集芯科技股份有限公司	消费电子、智能终端、无线通信、汽车电子等	4,152.07	5.40%
4	河北博威集成电路有限公司	通信电子、工业控制、汽车电子、消费电子等	3,211.19	4.18%
5	芯迈半导体技术(杭州)股份有限公司	移动终端、汽车电子、工业控制、数据中心等	3,067.52	3.99%
合计			23,741.68	30.89%
2024年度				
序号	客户名称	主要产品应用领域	销售金额	占比
1	南京微盟电子有限公司	消费电子、工业控制、汽车电子、智能家居等	5,457.17	8.19%
2	普冉半导体(上海)股份有限公司	消费电子、智能家居、工业控制、物联网等	4,373.48	6.56%
3	晟砂微电子(南京)有限公司	消费电子、智能家居、工业控制、小家电等	3,049.46	4.57%
4	河北博威集成电路有限公司	通信电子、工业控制、汽车电子、消费电子等	2,845.76	4.27%
5	钰太科技股份有限公司	消费电子、智能音频、智能终端、物联网等	2,834.70	4.25%
合计			18,560.58	27.84%
2023年度				
序号	客户名称	主要产品应用领域	销售金额	占比
1	钰太科技股份有限公司	消费电子、智能音频、智能终端、物联网等	5,070.44	9.15%
2	南京微盟电子有限公司	消费电子、工业控制、汽车电子、智能家居等	3,962.65	7.15%
3	普冉半导体(上海)股份有限公司	消费电子、智能家居、工业控制、物联网等	2,572.15	4.64%
4	晟砂微电子(南京)有限公司	消费电子、智能家居、工业控制、小家电等	2,147.93	3.88%
5	美芯晟科技(北京)股份有限公司	消费电子、智能家居、工业控制、汽车电子等	2,051.92	3.70%
合计			15,805.09	28.51%

2023 年度至 2025 年度,公司前五名客户销售金额合计占比分别为 28.51%、27.84%及 30.89%,整体占比相对稳定,不存在对单一客户或少数客户重大依赖的情形。

2025 年度,公司按销售金额分层的客户构成情况如下:

2025年销售金额范围	客户数量(家)
大于 1,000 万元	16
500 万元至 1,000 万元	17
50 万元至 500 万元	95
50 万元以下	378
合计	506

由上表可见,2025 年度公司销售金额超过 1,000 万元的客户数量为 16 家,销售金额超过 500 万元的客户数量合计为 33 家,50 万元至 500 万元客户数量为 95 家,客户层次较为丰富,既包括收入贡献较大的核心客户,也包括数量较多的中小客户,客户基础较为广泛。上述客户结构符合半导体封装测试行业客户较为分散的特点,有助于降低单一客户或单一下游应用领域波动对公司经营业绩的影响。

公司客户主要产品应用领域涵盖消费电子、通信、工业控制及汽车电子等终端市场。其中,消费电子相关领域受行业周期波动影响整体需求相对平稳;存储芯片行业呈现显著复苏特征;电源管理及功率器件等领域受益于新能源、AI 算力及汽车电子等新兴应用发展,需求保持增长态势。

公司客户主要产品应用领域涵盖消费电子、通信、工业控制、汽车电子、智能家居、物联网等终端市场,应用场景较为广泛。其中,存储芯片行业呈现复苏特征,电源管理及功率器件等领域受益于新能源、AI 算力及汽车电子等新兴应用发展,需求保持增长态势。

综上所述,2022 年至 2025 年公司持续亏损主要受半导体封装测试行业周期波动、下游需求阶段性变化、市场竞争加剧及产品结构升级等因素综合影响,同时公司为适应行业向中高端及先进封装方向发展趋势,持续加大产线建设及研发投入力度,上述投入在短期内对公司经营业绩形成一定压力。该等影响主要体现为对公司经营业绩的阶段性影响。

公司目前生产经营活动正常推进,主营业务持续开展,产品结构逐步优化,客户基础较为广泛且前五大客户销售占比整体稳定,订单获取未发生重大不利变化,不存在影响持续经营能力的重大不确定性。

(二)分析 2025 年第四季度公司盈利的原因,说明是否依赖于偶发性、非经常性因素,并分析扣除上述因素后的盈利情况,盈利能力是否发生实质性改善

2025 年第四季度,公司实现营业收入 23,823.90 万元,归属于母公司股东的净利润 128.48 万元,扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 179.71 万元,较前期亏损状态实现单季度由亏转盈。公司 2025 年第四季度盈利主要系下游需求恢复、订单规模增长、产能利用率提升、单位固定成本摊薄以及产品和客户结构优化等因素共同作用所致,具体分析如下:

1、下游需求恢复带动订单规模增长,产能利用率提升推动固定成本摊薄

2025 年第四季度,公司实现营业收入 23,823.90 万元,较 2025 年前三季度单季度平均营业收入 17,684.98 万元增长 34.71%,较 2024 年第四季度营业收入 17,111.04 万元增长 39.23%。从 2025 年内各季度收入变化情况看,公司第一季度至第四季度营业收入分别为 13,161.56 万元、19,429.09 万元、20,464.30 万元和 23,823.90 万元,呈逐季增长趋势,其中第四季度较第三季度增长 16.42%。上述收入增长主要系半导体封装测试行业景气度逐步回升,下游客户订单需求增加,公司订单交付规模扩大所致。

封装测试行业具有重资产投入特征,厂房、机器设备折旧及人工成本等固定或半固定成本占比较高。在收入和产量提升的情况下,公司现有生产线稼动率提高,固定资产折旧、人工薪酬等固定及半固定成本得到更充分分摊,从而推动单位成本压力下降并改善毛利率水平。2025 年第四季度,公司封装测试产能利用率为 92.67%,较 2025 年前三季度平均封装测试产能利用率 86.65%提升 6.02 个百分点,产能利用率提升对公司 2025 年第四季度毛利率改善及单季度盈利形成积极影响。

2、产品及客户结构优化

2025 年第四季度,随着下游需求恢复及公司产能利用率提升,公司订单承接能力和订单选择空间有所增强。公司在保障主要客户订单交付的基础上,结合客户需求、产品价格、产能安排及订单毛利水平,持续推进产品及订单结构优化。

一方面,公司持续推进 QFN/DFN 中高端封装产品的市场拓展和订单导入。该类产品工艺复杂度、技术要求及产品附加值相对较高,销售定价和毛利水平通常优于部分传统低毛利产品,有助于改善公司整体盈利水平。另一方面,随着订单需求恢复及产能利用率提升,公司对订单的承接选择空间有所改善,能够适当减少承接价格水平较低、毛利率较低的订单,从而降低低毛利产品对整体毛利率的拖累。

受收入规模扩大、产能利用率提升、固定成本摊薄及产品和订单结构优化等因素影响,2025 年第四季度公司毛利率较前期有所改善,并带动当期实现单季度盈利。

3、主要客户合作稳定,订单增长具有持续性

2025 年第四季度,公司订单增长主要来源于既有客户需求恢复、合作客户订单增加以及部分新产品、新客户导入,订单获取与公司长期客户基础、产品交付能力及行业需求恢复相匹配。公司主要客户合作关系较为稳定,相关销售产品与公司主营业务相匹配,不存在依赖单一客户、单笔大额订单或偶发性交易实现盈利的情形。因此,公司 2025 年第四季度盈利主要反映主营业务经营情况阶段性改善,而非依赖偶发性交易或短期非持续性订单。

4、扣除非经常性损益后仍实现盈利,不存在对偶发性、非经常性因素的依赖

2025 年第四季度,公司归属于母公司股东的净利润为 128.48 万元,扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润为 179.71 万元,扣非后净利润仍为正且高于归属于母公司股东的净利润,说明公司 2025 年第四季度盈利并非依赖政府补助、资产处置收益等非经常性损益形成,而主要来源于营业收入增长、产能利用率提升、固定成本摊薄及产品和订单结构优化等主营业务改善因素。

2026 年第一季度,公司实现营业收入 22,344.44 万元,同比增长 69.77%,毛利率为 10.57%,较上年同期、2025 年度的毛利率 -4.55%、5.33%大幅提升,归属于母公司股东的净利润为 -372.46 万元,较上年同期的 -3,217.24 万元,同比收窄 88.42%。

综上所述,2025 年第四季度公司实现盈利,主要系行业景气度回升、下游需求恢复带动订单规模增长,同时产能利用率提升、单位固定成本摊薄及产品和客户结构优化共同推动毛利率改善所致。公司 2025 年第四季度盈利主要来源于主营业务经营改善,不存在依赖政府补助、资产处置收益等偶发性、非经常性因素实现盈利的情形;扣除非经常性损益后,公司当期仍实现盈利。公司主营业务已经实质性好转,盈利能力得以实质性改善。

(三)说明公司已采取和拟采取的改善经营业绩的具体措施(如产品结构优化、客户拓展、成本控制、资产处置等),并量化分析相关措施预计产生效益的时间、金额及可实现性

针对公司持续亏损,公司持续采取多种措施,改善公司的经营状况。具体如下:

1、降本增效

公司在成本控制方面,主要采取了以下措施:

(1)辅材的降本控制

公司连续两年推出辅助材料降本微励控制,每年设立降本目标与挑战值。运营部门全面分解公司各种辅助材料使用状况与降本方案。万只耗材成本从高峰期的 85.07 元,降低至 2025 年度的 59.40 元,降幅达 30.18%。按 2025 年度 119 亿只入库产量计算,降本约 3,054.73 万元。公司将持续对辅助材料进行跟踪考核管理,进一步降低使用成本。

(2)人工成本控制

公司自 2025 年初开始进行了人力成本优化,采取人员流动少补、合理化化冗余人员的方式,整体优化人数超过 200 人,并严格设立人员编制管理制度,严控产量增加时的人员增编管理。

按优化人员平均月人工成本 10,000.00 元计算,每年节约人工成本 2,400.00 万元。2024-2025 人工费用占销售收入的比例如下表:

单位:万元

期间	营业收入	人工费总额	人工费占收入的比例(%)
2024年度	66,656.25	23,279.63	34.92
2025年度	76,878.86	23,264.69	30.26

2、产品结构优化

2025 年度与 2024 年度产品结构对比如下表:

单位:万元

项目	2025年	占比(%)	2024年	占比(%)
常规封装收入	36,309.76	49.81	36,318.27	58.21
中高端封装收入	28,321.26	38.85	23,384.34	37.48
功率器件收入	8,258.62	11.33	2,688.06	4.31
合计	72,889.64	100.00	62,390.67	100.00

从上表可以看出,2025 年度的收入提升主要体现在中高端封装与功率器件产品上。

(1)大力开拓中高端封装产品

2025 年公司大力开拓中高端封装产品,营业收入同比上年增加了 4,936.92 万元,同比增加 21.11%。

2026 年一季度先中高端装同比 2025 年一季度变动如下表:

单位:万元

项目	2026年一季度	2025年一季度	同比增量	增加比例
中高端封装收入	8,517.49	5,079.91	3,437.58	67.67%

由于产能不足的影响,严重制约了公司中高端封装的接单能力,公司正大量投资生产设备,以满足中高端封装的产能需求,预计 2026 年度将有更大幅度的提升。

(2)功率器件产品的持续增量

功率器件产品作为公司新布局的产品线,自 2024 年下半年起快速上量,2025 年度实现销售收入 8,258.62 万元,同比增长了 207.23%。2026 年一季度销售收入 3,031.49 万元,同比增长 508.60%。

(3)晶圆测试业务布局成效初显

晶圆测试子公司 2023 年、2024 年、2025 年收入利润如下表:

单位:万元

项目	2023年度	2024年度	2025年度	2026年1-5月
营业收入	119.22	340.74	883.51	786.96
净利润	-329.38	-704.17	-976.53	-32.58

从上可知,公司子公司晶圆测试业务收入快速增长,成效初显。

3、加大客户拓展力度

销售部门制定深挖潜力老客户,大力拓展战略新客户的营销策略。

(1)优质老客户的深度开拓

对优质老客户,公司采取的措施是努力拓展中高端产品,增加先进封装份额。适当控制竞争激烈的低端产品订单量,实现互利共赢、持续高质量增涨的目标,英集芯、普冉股份等一批优质客户实现了产品多元化合作。

(2)新客户的开拓

对于战略新客户,公司采用专线管理或类专线管理模式,最大程度满足客户要求,中兴微电子、兆易创新等核心战略新客户,公司分别设立了专线,现处于快速上量阶段。如艾为、南芯等也进入了起量阶段。

(四)列示 2025 年第四季度前五大客户、合作历史、2025 年各季度销售金额、第四季度末应收账款余额、期后回款及退换货情况等

1、列示 2025 年第四季度前五大客户、合作历史、2025 年各季度销售金额

(1)2025 年第四季度前五大客户、合作历史

排名	公司	合作历史
1	南京微盟电子有限公司	2012年
2	普冉半导体(上海)股份有限公司	2016年
3	芯迈半导体技术(杭州)股份有限公司	2022年
4	深圳英集芯科技股份有限公司	2016年
5	河北博威集成电路有限公司	2013年

如上表所示,公司 2025 年第四季度前五大客户均是公司 2024 年及以前就开始合作,不存在 2025 年第四季度新增前五大客户。

(2)2025 年第四季度前五大客户在 2025 年各季度销售金额

2025 年第四季度前五大客户在 2025 年各季度销售金额如下所示:

单位:万元

公司名称	2025年第一季度	2025年第二季度	2025年第三季度	2025年第四季度	2026年第一季度
南京微盟电子有限公司	1,206.97	1,954.52	1,892.93	3,255.38	1,997.13
普冉半导体(上海)股份有限公司	852.24	1,034.59	1,041.39	2,072.87	1,788.57
芯迈半导体技术(杭州)股份有限公司	154.89	577.08	875.45	1,460.10	1,798.06
深圳英集芯科技股份有限公司	679.72	1,064.69	1,210.31	1,197.36	1,452.16
河北博威集成电路有限公司	683.94	775.10	731.32	1,020.83	587.79

如上表所示,公司 2025 年第四季度前五大客户在 2025 年各季度的变动趋势基本一致,2025 年呈现逐季度增长的趋势。其中,2025 年第四季度较前几季度增长较多的原因系 2025 年四季度半导体行业复苏,订单量增加所致。2025 年第四季度与 2026 年第一季度相比,除南京微盟电子有限公司、河北博威集成电路有限公司下降较多外,其他客户下降较少或呈现上升趋势,南京微盟电子有限公司 2026 年第一季度销售下降较多的原因系 2026 年 2 月份春节,发货量较少所致,但南京微盟电子有限公司在 2026 年一季度的订单量增长较多;河北博威集成电路有限公司的产品主要是用于 5G 基站的氮化镓射频器件,终端供货渠道高度集中于中兴通讯,客户结构相对单一。经向客户河北博威集成电路有限公司了解,终端客户在 2026 年一季度下的订单偏少;2025 年第四季度前五大客户在 2025 年各季度及 2026 年一季度订单量如下所示:

单位:万只

公司名称	2025年第一季度	2025年第二季度	2025年第三季度	2025年第四季度	2026年第一季度
南京微盟电子有限公司	38,369.19	49,346.15	61,997.62	68,364.49	78,020.28
普冉半导体(上海)股份有限公司	14,218.08	20,520.77	26,954.07	31,500.42	30,935.47
芯迈半导体技术(杭州)股份有限公司	1,604.88	2,466.56	5,373.20	6,444.96	7,363.88
深圳英集芯科技股份有限公司	8,584.43	22,616.21	17,567.46	12,803.37	18,829.73
河北博威集成电路有限公司	327.00	356.64	427.90	394.80	294.68

如上表所示,2025 年第四季度前五大客户除河北博威集成电路有限公司外,2025 年各季度及 2026 年一季度订单量呈现持续增长趋势,河北博威集成电路有限公司的产品主要是用于 5G 基站的氮化镓射频器件,终端供货渠道高度集中于中兴通讯,客户结构相对单一。经向客户河北博威集成电路有限公司了解,终端客户在 2026 年一季度下的订单偏少;综上,2025 年四季度营业收入较前三个季度增加具有合理性。

2、第四季度末应收账款余额、期后回款及退换货情况等

单位:万元

单位名称	第四季度末应收账款余额	期后回款	期后回款率
南京微盟电子有限公司	1,976.25	1,976.25	100.00%
普冉半导体(上海)股份有限公司	775.09	775.09	100.00%
芯迈半导体技术(杭州)股份有限公司	908.76	908.76	100.00%
深圳英集芯科技股份有限公司	459.57	459.57	100.00%
河北博威集成电路有限公司	504.56	504.56	100.00%

注:期后回款系截止 2026 年 5 月 31 日。

如上表所示,截止 2026 年 5 月 31 日,公司 2025 年第四季度前五大客户应收账款期后回款率均为 100%。2025 年度,公司存在少量的因产品加工质量问题导致的质量赔偿款支出 566.44 万元,不存在退换货的情形。

(五)结合 2025 年第四季度及 2026 年第一季度发货及验收时点、收入确认依据、成本费用归集期间、期后回款及退换货情况,核实并说明 2025 年第四季度是否存在突击确认收入、推迟确认成本费用以及跨期调节利润等情形,请年审会计师详细说明针对收入成本费用所执行的截止性测试、细节测试情况

1、结合 2025 年第四季度及 2026 年第一季度发货及验收时点、收入确认依据、成本费用归集期间、期后回款及退换货情况,核实并说明 2025 年第四季度是否存在突击确认收入、推迟确认成本费用以及跨期调节利润等情形

(1)2025 年第四季度和 2026 年第一季度发货量与收入确认量对比如下:

单位:万只

期间	发货量	收入确认数量	收入确认数量占发货量比
2025年第四季度	367,344.06	344,442.78	93.77%
2025年10月	118,065.61	87,617.12	74.21%
2025年11月	114,561.59	122,177.24	106.65%
2025年12月	134,716.86	134,648.43	99.95%
2026年第一季度	330,649.16	311,083.77	88.96%
2026年1月	113,761.31	78,688.83	69.17%
2026年2月	89,469.53	88,581.64	99.01%
2026年3月	127,418.31	126,887.94	99.58%

注:月度收入确认数量是指该季度内发货并确认收入的数量。

如上表所示,2025 年第四季度和 2026 年第一季度收入确认数量占发货量的占比变动不大,且在上述期间内发货并确认收入的数量占比较高,2025 年第四季度不存在突击确认收入的情况。

(2)验收时点:公司将货物运至客户指定地点,客户进行验收。

(3)公司收入确认依据为:①对于境内收入,公司将货物运至客户指定地点,经客户验收,并经双方对账无误后确认收入;②对于境外收入,公司将产品装箱后出口,根据出口报关单金额开具出口发票并确认收入。

(4)公司按照权责发生制原则将成本费用归集到正确期间。2025 年第四季度与 2026 年第一季度成本费用金额及占营业收入比重情况如下所示:

单位:万元

项目	2025年第四季度		2026年第一季度	
	金额	占营业收入比重(%)	金额	占营业收入比重(%)
营业收入	23,823.90	–	22,344.44	–
营业成本	20,252.33	85.01	19,982.24	89.43
销售费用	489.16	2.05	500.81	2.24
管理费用	1,337.57	5.61	1,099.66	4.92
研发费用	1,302.12	5.47	1,317.11	5.89
财务费用	710.91	2.98	555.20	2.48

如上表所示,2025 年第四季度和 2026 年第一季度各成本费用占营业收入的比重变动不大,2026 年第一季度营业成本占比较 2025 年第四季度增加,主要系 2026 年 2 月份春节放假,公司产能下降引起的。

(5)公司 2025 年第四季度前十大客户占比为 53.36%,前十大客户收入确认金额、期后回款及期后退货情况如下表所示:

单位:万元

单位名称	第四季度收入确认金额	期后回款	期后回款率
南京微盟电子有限公司	3,255.38	1,976.25	100.00%
普冉半导体(上海)股份有限公司	2,072.87	775.09	100.00%
芯迈半导体技术(杭州)股份有限公司	1,460.10	908.76	100.00%
深圳英集芯科技股份有限公司	1,197.36	459.57	100.00%
河北博威集成电路有限公司	1,020.83	504.56	100.00%
兆易创新科技集团股份有限公司	982.77	615.82	100.00%
天钰科技股份有限公司	755.34	536.67	100.00%
深圳思派微电子有限公司	728.92	769.77	63.41%
江阴江迪金属材料有限公司	631.59	–	100.00%
矽力杰半导体技术(杭州)有限公司	607.83	264.38	100.00%

注:1、期后回款系截止 2026 年 5 月 31 日;

2、公司对江阴江迪金属材料有限公司收入已于 2025 年 12 月 31 日前回款。

如上表所示,截止 2026 年 5 月 31 日,公司 2025 年第四季度前十大客户除深圳思派微电子有限公司外,其他客户期后回款率均超过 90%,不存在退换货的情况。深圳思派微电子有限公司截止 2026 年 5 月 31 日回款率较低的原因主要系该客户受终端客户的影响,回款较慢,但该客户每月陆续回款,2026 年 6 月份已回款 193.23 万元,截止 2026 年 6 月 30 日,回款率为 79.33%。

(6)2025 年四季度营业收入大幅增长的原因及商业合理性分析

同行业上市公司或挂牌公司 2025 年第四季度营业收入占比如下:

单位:万元

公司简称	2025年第四季度收入	全年收入	占比
长电科技	1,020,237.57	3,887,134.83	26.25%
华天科技	483,412.58	1,721,391.53	28.08%
通富微电	780,516.58	2,792,142.48	27.95%
甬矽电子	122,841.13	439,836.62	27.93%
华宇电子	23,504.50	81,665.78	28.78%
气派科技	23,823.90	76,878.86	30.99%

如上表所示,同行业上市公司或挂牌公司 2025 年第四季度营业收入占比均超过 25%,与公司 2025 年四季度营业收入占比差异较小。

公司第四季度营业收入占全年营业收入比例为 30.99%,占比较高,从报告期内业务开展情况来看,主要原因系 2025 年下半年半导体行业市场回暖订单增加,同时销售单价略有增加所致,2025 年各季度订单数量、销量及销售单价变动情况如下:

单位:万只、万元、元/只

期间	订单来料数量	生产入库数量	销售数量	封测收入	封测平均单价
2025年一季度	219,905.60	215,864.29	202,820.11	12,651.27	0.0624
2025年二季度	315,696.76	288,535.06	309,529.36	18,189.63	0.0588
2025年三季度	372,329.11	330,133.49	315,101.50	18,697.43	0.0593
2025年四季度	335,510.68	358,902.28	369,314.77	23,351.31	0.0632

如上表所示,2025 年各季度订单数量分别为 219,905.60 万只、315,696.76 万只、372,329.11 万只、335,510.68 万只,随着半导体市场的回暖,订单数量陆续增加,故 2025 年各季度产量也逐步提升,2025 年各季度销售数量分别为 202,820.11 万只、309,529.36 万只、315,101.50 万只、369,314.77 万只,2025 年三季度订单量高于 2025 年四季度,但销量低于 2025 年四季度主要系三季度部分订单在四季度排产交付所致。如上表所示,2025 年各季度销售单价逐步